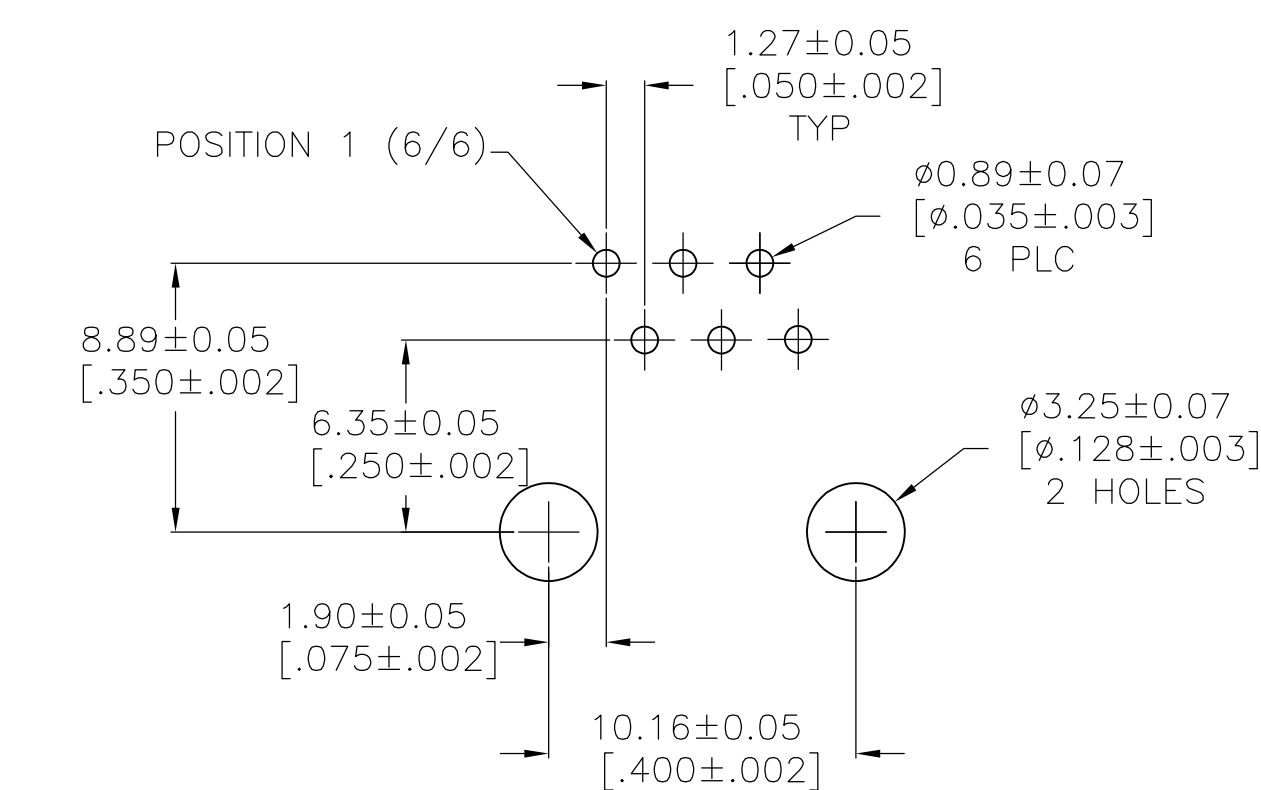
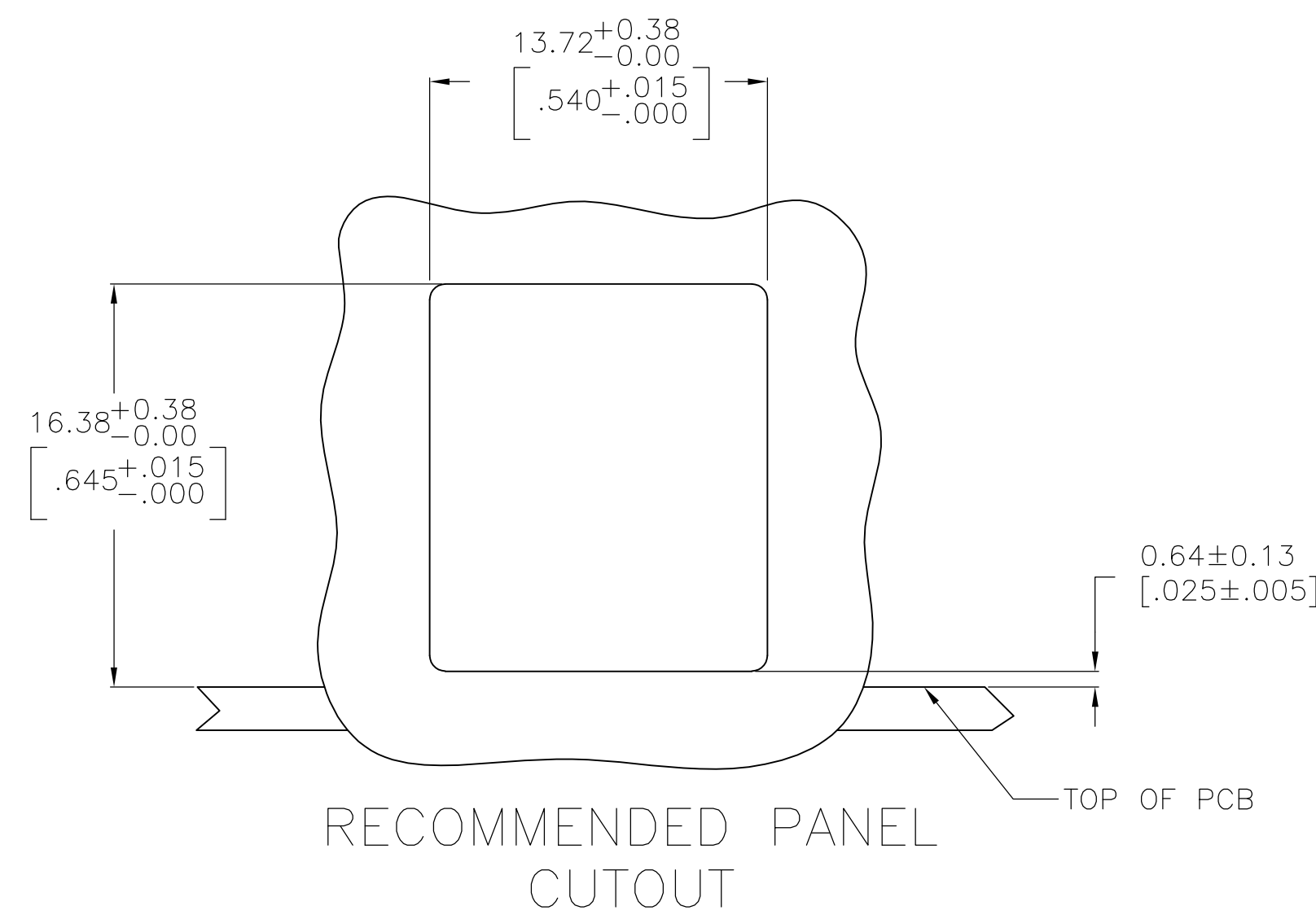
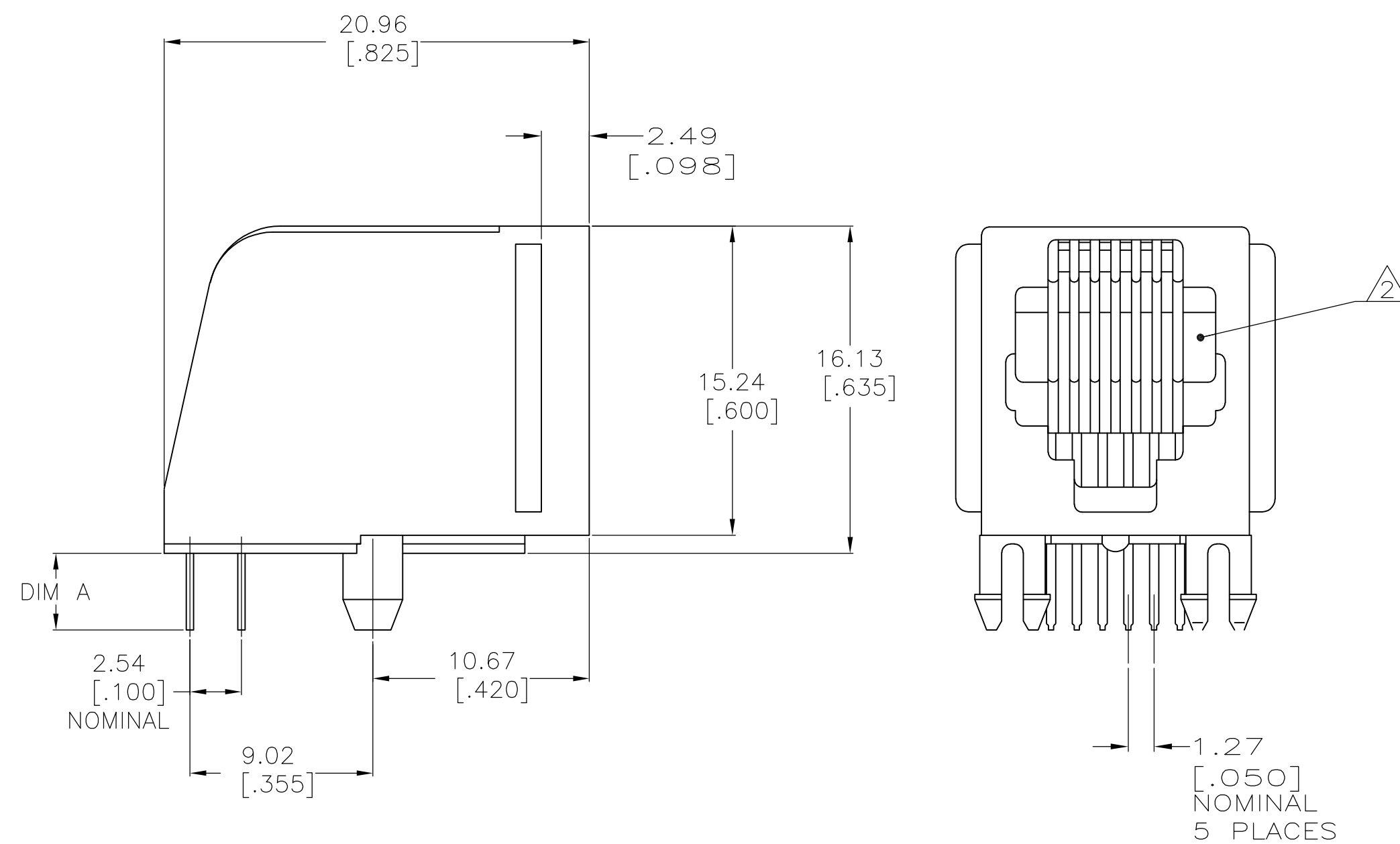


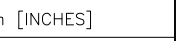
LOC	DIST	REVISIONS					
GP	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			D2	REVISED PER ECO-12-014371	15NOV2012	CJV	PAR



RECOMMENDED PRINTED CIRCUIT BOARD
LAYOUT
COMPONENT SIDE SHOWN

1. MATERIAL:
HOUSING — PBT POLYESTER, COLOR: BLACK
TERMINAL — 0.36[.014] THICK PHOS BRONZE PLATED
WITH (SEE TABLE) MIN HARD GOLD IN LOCALIZED GOLD PLATE
AREA AND 2.03μm[.000080] MIN THICK MATTE TIN IN SOLDER
AREA OVER 1.27μm[.000050] MIN THICK NICKEL UNDERPLATE
- △ CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS
PART 68 AND REA BULLETIN 345-81, PE-76
SPECIFICATION FOR MODULAR TELEPHONE HARDWARE.
- △ 0.15μm[.000006] GOLD PLATED PARTS DO NOT MEET
THE MINIMUM GOLD THICKNESS REQUIREMENT OF
FCC SPECIFICATION, PART 68. PARTS HAVE NOT BEEN
TESTED TO THE DURABILITY REQUIREMENTS OF
TE PRODUCT SPEC 108-1163
- △ TERMINALS FOR 5520250-1 AND -2 LOCATED IN
CENTER POSITIONS
5. DIMENSIONS ARE MAXIMUM UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

OBSOLETE	0.15μm[.000006] 	3.30—4.32 [.130—.170]	6	2—5520250—3
			4 	2—5520250—2
	1.27μm[.000050]	2.16—2.67 [.085—.105]	4 	1—5520250—1
		3.30—4.32 [.130—.170]	6	5520250—3
			4 	5520250—2
			2 	5520250—1
	GOLD THICKNESS	DIM A	TERMINALS REQUIRED	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 12MAY2005 T. WOOTEN/L.A.MAYER CHK 12MAY2005 J.WESTMAN APVD 12MAY2005 S.FUCKINGER		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± 0.13[.005] 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -		NAME MODULAR JACK ASSEMBLY, 6 POSITION, SIDE ENTRY, FLANGELESS, WITH PANEL STOPS	
		PRODUCT SPEC 108-1163 APPLICATION SPEC 114-2048		SIZE CAGE CODE DRAWING NO	
MATERIAL SEE NOTE 1		FINISH SEE NOTE 1		WEIGHT - CUSTOMER DRAWING	
				A1 00779 C=5520250	
				SCALE 4:1 SHEET 1 OF 1 REV 02	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9